

# 企业质量信用报告

常州银河世纪微电子供方有限公司

2022 年 4 月

# 目 录

1 前言	1
1.1 编制说明	1
1.2 总经理致辞	1
1.3 企业简介	2
2 企业质量理念	3
3 企业质量管理	3
3.1 质量管理机构	3
3.2 质量管理体系	4
3.3 质量安全风险管理	5
3.3.1 质量风险监测	5
3.3.2 应急管理	5
4 质量诚信管理	5
4.1 质量承诺	5
4.2 运作管理	6
5 质量管理基础	8
5.1 标准管理	8
5.2 认证管理	8
5.3 检验检测管理	8
5.4 计量管理	9
6 产品质量责任	9
6.1 产品质量水平	9
6.2 产品售后责任	11
6.3 企业社会责任	12
6.4 质量信用记录	12
7 结语	13

# 企业质量信用报告

## 1 前言

### 1.1 编制说明

本报告是我司发布的 2021 年度的质量信用报告。

报告组织范围：常州银河世纪微电子股份有限公司。

报告时间范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

报告发布周期：年度报告。

报告数据说明：本报告采用数据来自于常州银河世纪微电子股份有限公司。

报告获取形式：本报告以电子文档形式发布。

报告获取网址：<http://www.gmesemi.com>

### 1.2 总经理致辞

常州银河世纪微电子股份有限公司始终肩负着区域经济和國家繁荣的企业使命，坚持“以品质赢得市场，用创新提升优势”的质量方针，坚决落实把质量放在第一位的思想。为确保质量诚信体系的有效运行，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施品牌战略上加以提升，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断提升企业的质量诚信建设。

先有满意的员工，后有满意的顾客，这是所有企业都信奉的员工与客户关系。公司自建厂以来，脚踏实地、积极进取，认真贯彻 ISO9001、IATF16949 等国际质量管理体系标准，用科学的管理方法努力提升公司经营绩效。凭借过硬的产品质量、齐全的产品种类，快速交付的能力和全过程的技术保障服务，公司产品得到了广大用户的认可，市场占有率快速增长，银河品牌深入人心。

未来，公司将继续坚持“诚实守信，拼搏创新，精益求精，合作共赢”的核心价值观，致力于成为半导体分立器件行业的领先企业，努力为客户创造价值，为员工提供平台，为股东实现回报，为社会做出贡献。公司将继续实施技术创新，专注于半导体分立器件行业做精做强，进一步拓宽产品种类，提升产品性能，提高产品档次；公司将继续推进结构调整，坚持纵向一体化发展战略，全面优化芯片和封测

技术，增强生产柔性和效率，扩大经营规模；公司将继续坚持市场导向，提升市场营销能力，强化技术服务支撑，拓展国内外中高端市场领域，全面提升公司的盈利能力！

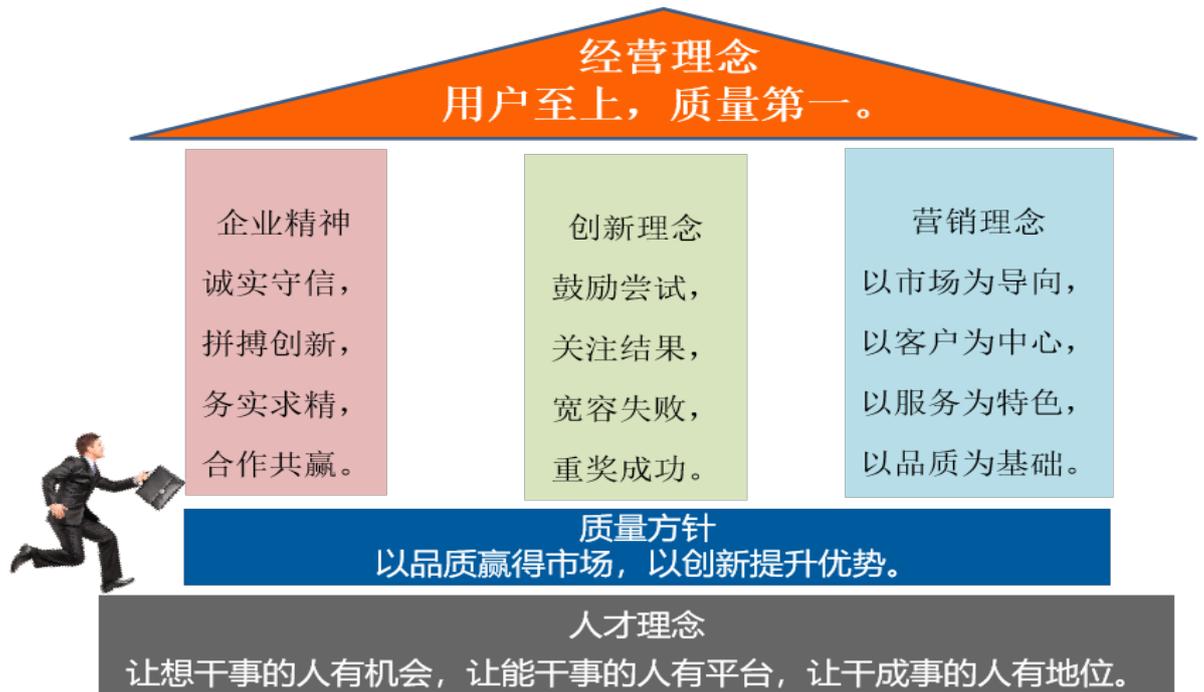
### 1.3 企业简介

常州银河世纪微电子股份有限公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括各类半导体二极管、三极管、桥式整流器、光电耦合器、LED 灯珠等半导体分立器件。目前，公司已掌握 20 多个门类、近 80 种封装外形产品的设计技术和制造工艺，已量产 8,000 多个规格型号。公司以封装测试专业技术为基础，具备 IDM 模式下的一体化经营能力，可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购需求。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域。

公司自 2010 年起连续被评为江苏省高新技术企业、常州市重点培育和发展的出口名牌等，被中国半导体行业协会评为“中国半导体功率器件十强企业”、“中国分立器件封装产能十强企业”，2021 年 1 月 27 日成功在上交所挂牌上市。公司技术中心属于“江苏省认定企业技术中心”，建有“江苏省半导体分立器件芯片与封装工程技术研究中心”、“江苏省片式半导体分立器件工程技术研究中心”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 202 项，其中发明专利 24 项。公司已成功加入国际汽车电子协会，在半导体器件领域与英飞凌、安森美等公司同为该协会技术委员会（AEC Technical Committee）成员。

公司将秉承“用我们的努力，创造顾客的辉煌”的长期服务理念，以最优质的产品和最高效的服务期待着与世界各地的客户开展最广泛的合作！

## 2 企业质量理念

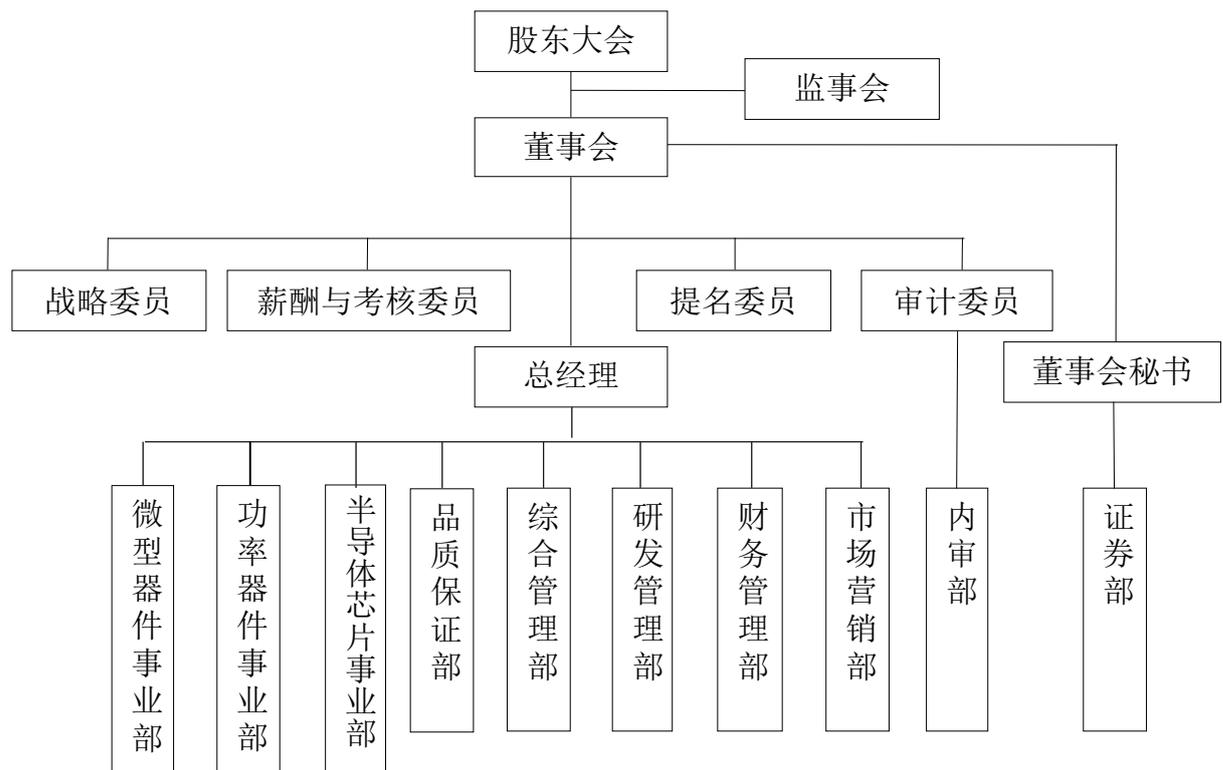


## 3 企业质量管理

### 3.1 质量管理机构

公司品质保证部全面负责质量管理各项工作。

图 3.1-1 公司组织架构图



### 3.2 质量管理体系

公司坚持“以品质赢得市场，用创新提升优势”的质量方针，建立了完善的品质管控体系。通过质量控制、质量管理、质量工程来保证公司的产品质量，在顾客需求识别、设计开发、原材料检验、供应商管理、生产过程控制、出厂检验和试验、质量统计分析、工艺改进、客户服务、产品规范、产品应用等方面进行严格把关，确保出厂产品品质满足客户要求。

自公司成立以来，逐步建立并通过了 ISO9001、IATF16949、QC080000 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。所有产品符合欧盟的 RoHS、REACH 等法规要求，并可按客户需要提供无卤素产品。多款产品还通过了 UL、VDE、CQC、FI、中国电网、AECQ101 等认证。公司已具有满足生产汽车电子、工业控制等领域高质量、高可靠性要求产品的能力。

品质源于设计。在产品的设计开发初期，就以市场及客户的需求为基础，制订详细的产品和过程开发计划，组织多方论证小组按照 APQP 管理流程，采用 FMEA 的方法，对产品生产和应用过程中可能存在的失效模式进行分析和评价，依据风险评价的结果选择最佳的原辅材料、工艺路线和生产控制方法。防呆技术的充分应用，以及在产品开发的关键节点，组织相关部门及专业人员从人、机、料、法、环等各方面对开发项目进行评审和验证，最大限度的降低量产后产品可能出现的质量风险，从源头确保品质。在原材料控制环节，制订了《供方管理程序》《采购程序》《进货检验程序》，对供应商的综合资质、供货能力、HSF 管控能力、质量控制体系、材料质量水平进行监控和评价，确保材料符合要求。在产品制造过程，通过对关键过程/产品参数进行监控，运用 MSA、SPC 工具，消除过程变异，确保各过程均处于受控状态。在测试工序，针对关键电性参数，采用 PAT 管理技术，剔除离散点，降低客户端产品的使用风险。

创建了独立的可靠性试验室，配备了半导体行业的专用试验、分析设备。具备按照 MIL、JEDEC、AECQ101 等标准要求进行了可靠性试验、应用场景验证以及产品失效分析的能力。

公司及其子公司在国内外拥有数十项注册商标，其中“BILIN”

商标被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标，“G 牌硅塑封微贴片半导体分立器件”是江苏省名牌产品。公司凭借多年积累所形成的品牌知名度，大力拓展市场，不断提升公司的经营业绩，推动公司长期良性发展。

### **3.3 质量安全风险管理**

#### **3.3.1 质量风险监测**

公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库，不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，定期分析质量状况，开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障，全面降低了质量安全风险。

#### **3.3.2 应急管理**

公司设立了应急救援指挥部，针对经营管理活动中的可能存在的自然灾害、能源/资源短缺、火灾爆炸、化学品泄漏、生产安全事故、新冠疫情等突发事件，制订了《应急计划》《突发环境事件应急预案》《生产安全事故应急预案》《新冠疫情防控应急预案》等管理文件，通过每年组织应急演练、预案评审等方式不断提升公司的应急处理意识和能力，规避风险，最大限度保护员工生命安全、公司财产安全，规避经营风险。

## **4 质量诚信管理**

### **4.1 质量承诺**

作为半导体分立器件专业生产企业，公司确保产品的安全和遵守有关法律法规，包括《产品质量法》、《标准化法》、ISO9001:2015《质量管理体系要求》等。严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈顾客等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

依据公司的规定，所有经销商、分销商、终端卖场和消费者都是本公司的顾客。销售部通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以

此作为改进的依据。最高管理层依据质量、法律法规及相关方要求，基于本公司产品、市场定位以及顾客的反馈，明确本公司的顾客和顾客的要求及其期望，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。

## 4.2 运作管理

**研发模式：**公司研发管理部负责公司新产品项目的策划和设计过程的控制，技术总监负责产品设计输出文件的批准。设计开发输入信息主要来自对市场的分析，包括顾客的需求与期望，以及行业适用的相关标准、规范、法律法规要求。通过实施项目调研和立项、产品设计和开发、产品验证和确认的全过程管理，由公司市场营销部、研发管理部收集客户和市场的产品需求，经立项评审同意开发后，由工程师进行产品设计、工艺设计，经样件试制后设计定型、试生产后工艺定型，并进行初期流动管理，确认产品成熟后进入正常量产阶段。另外，在技术储备研发方面，公司根据市场需求趋势以及公司规划的发展方向，有针对性的对新工艺、新技术进行储备研发，以提升自身的核心技术水平，新的工艺、技术通过小批量的试生产及验证后作为公司的技术储备配合后续的产品、客户开发活动。

**采购模式：**公司采购的原材料主要为芯片、框架/引线、塑封料、硅片等，公司采购采用集中管理、分散采购的模式，将管理的规范性和适应市场的灵活性有效地结合起来，并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式，达到兼顾快速交付订单和有效管控资金的要求。公司制定了《供方管理程序》、《采购管理程序》、《供方管理手册》、《材料认定程序》等文件，对供方导入、日常采购操作、供应商考评等工作以规范性指导。公司合格供应商均需要签订采购协议、质量保证协议、相关技术协议、环保安全协议、知识产权保护协议、有害物质限值协议或保证函等。对每家供应商的供货质量、及时交付率、环保、服务、价格等方面公司统一组织月评和年评，建立优胜劣汰的机制，以确保公司采购管理水平的不断提升。分散采购是指各产品事业部根据生产计划需求及原材料库存编制采购计划并实施。采购范围必须是在合格供方名单及已认定的材料清单内。公司以采购订单方式与

供应商约定交付要求，确保沟通快速、供货及时和验收合格。材料价格是影响采购的重要因素，在同等品质的前提下，公司优先选择价格更有竞争力的供应商，从而有效控制公司的采购成本。

**生产模式：**公司采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化生产。同时，公司以市场为导向，努力构造适应客户需求的多品种、多批次、定制、快捷的柔性化生产组织模式。公司根据销售订单下达销售计划，各产品事业部根据订单交期确定产品的生产排期，安排产品生产，确保按时交付。同时，公司市场营销部也会根据远期订单和对未来市场需求的预测，以及重点客户的备货要求，下达销售备货计划。各产品事业部根据生产周期、安全库存和产能综合利用效率，合理安排采购和作业计划，储备部分关键材料或直接做成半成品。一旦接到正式订单时，可以根据要求在半成品中选择适用的批次进行测试、打印、包装，实现快捷交付。一方面缩短了产品的交货周期，提高了产线的交付能力和应变能力，提升了公司的市场竞争能力；另一方面能够通过这样的计划安排，提高公司各类产能资源的有效利用率，确保生产的相对持续性和稳定性，提升公司的经济效益。

**营销模式：**公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采用以直销为主、经销为辅的营销模式，并利用丰富的产品种类和专业化的支持，为客户提供一站式采购服务。对于大多数客户，公司首先需要接受其严格的供应商资质审查和现场管理审核，还要对相关产品进行全面的试验验证。审核时间少则数月，多则需要一两年时间，甚至更长，只有在审核全部通过后才能进入客户的供应商名录。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队。当客户下达样品订单时，公司技术服务团队从产品选型、参数设定、应用验证等方面与客户进行沟通，确保样品满足客户使用要求。在客户下达订单后，公司按照约定交期及时安排生产并及时供货。在产品交付后，公司加强跟踪服务，以确保客户满意。

## 5 质量管理基础

### 5.1 标准管理

公司按照 ISO9001、IATF16949、QC080000 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并利用质量方针、目标，管理评审、内部审核、数据分析、控制措施组合的确认和验证等“过程方法”工作，使本公司的质量管理体系得以持续的改进。

生产过程的确立及输入、输出的活动，均按照生产控制计划实施检查和处理的 PDCA 循环程序进行，通过防呆技术的应用、关键控制点进行 SPC 监控、作业准备验证、设备关键参数确定及预防性维保活动确保产品质量全过程受控。另外公司还积极推进 QIT/QCC（质量改善小组）活动、内部管理体系运行情况评估、外部审核问题点的深入分析和整改等活动来推动内部管理的持续改善，保证公司管理效率和管理效益的不断提升。

### 5.2 认证管理

公司先后通过了 ISO9001、IATF16949、QC080000 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系认证。所有产品符合欧盟的 RoHS、REACH 等法规要求，并可按客户提供无卤素产品。多款产品还通过了 UL、VDE、CQC、FI、中国电网、AECQ101 等认证。

### 5.3 检验检测管理

质量把关是质量检验最重要、最基本管理。公司一向秉持着质量第一的原则，严格进行检验检测的管理，确保产品质量符合客户要求。

检验按生产过程分类包括进货检验、过程检验、最终检验；按检验地点分类包括集中关卡检验、巡回检验；按检验方法分类包括理化检验、感官检验、试验。公司有参考半导体行业相关标准和客户要求，制订了包括材料、半成品、成品质量检验标准，配备了专业的检验检测试验设备和专业的训练有序的检验人员。日常找工作中做到有法可依，有法必依，执法必严，记录有据。当质检员与生产进度发生矛盾时，要树立质量第一、质量至上的观念，做好质量检验工作，并处理好两者之间的关系。

## 5.4 计量管理

公司严格执行《中华人民共和国计量法》，经营管理过程中所使用的计量器具/设备均由专业公司制造，确保其精准度符合标准要求。公司制订了《监视和测量设备管理程序》，设置了专职计量管理人员，负责所有计量器具和设备的登记、编号、下发和定期校检工作，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

## 6 产品质量责任

### 6.1 产品质量水平

分立器件制造过程标准化程度高，技术一般与特定的工艺环节相结合，一旦解决某个工艺节点的特定问题，则该技术可以广泛应用于采用该种工艺的多系列产品。

公司掌握了行业主流的分立器件封装测试通用技术，对涉及的组装、成型、测试过程进行工艺优化实现精确控制，并逐步掌握了功率二极管部分品类芯片的设计和制造技术，具体如下：

项目所需技术	现有核心技术	技术描述及特点	使用该项核心技术的主要产品	
分立器件封装测试	组装技术	高密度阵列式框架设计技术	框架设计多排化使每条框架产品数增加，同时提高单位面积内的产品数，提高生产效率及降低材料消耗。以 SOT-23 为例，使用该技术使每平方厘米产品数从 4.75 颗提高至 5.71 颗，密度提高 20%。	小信号二极管、光电耦合器、功率二极管、桥式整流器
		芯片预焊技术	将锡膏或焊片预焊在芯片两面，增加一道工序，在提升焊接工序效率，减少芯片沾污方面有明显效果，焊接气孔由 5%减少到 3%以下。	桥式整流器
		点胶量 CPK 自动测量控制技术	通过自动检测每个产品的点胶量进行统计过程控制，提高芯片的受控程度，确保每个点位的胶量都在受控范围。	功率二极管、桥式整流器
		功率芯片画锡焊接技术	是通过特殊的点胶针头在点胶范围内均匀行走，达到胶量更均匀位置更可控，从而达到焊锡均匀、焊接气孔减少的目的，可提升功率器件的性能和可靠性。	功率二极管
		高温反向漏电控制技术	通过聚酰亚胺胶替代硅橡胶、引线结构优化排出胶体气泡，结合二次上胶降低聚酰亚胺胶体缺陷等技术，提高 OJ 芯片产品的高温性能，使产品在高温下反向漏电更小。	功率二极管

项目所需技术	现有核心技术		技术描述及特点	使用该项核心技术的主要产品
		跳线焊接技术	在框架焊接工艺中采用跳线完成芯片上表面的电极与框架的连接,有效降低芯片所受应力,降低产品在失效风险。	功率二极管、桥式整流器
	成型技术	MGP 模封装技术	采用多注射头封装模具,多料筒、多注射头封装形式,优势在于可均衡流道,实现近距离填充,树脂剪用率高,封装工艺稳定。	小信号二极管、功率二极管
	测试技术	基于产品特性数据分析的测试技术	针对芯片对产品特性的影响,通过分析量化,制定测试方案,并用 PAT 方法筛选出产品性能离散及有潜在失效模式的产品。	小信号二极管、小信号三极管、功率三极管、功率三极管、桥式整流器、光电耦合器
		基于 FMEA 的测试技术	针对生产过程中各工序品质状况对产品特性的影响,通过分析量化,制定测试方案,筛选出生产过程中的潜在异常品及有潜在失效模式的产品。	
功率二极管芯片制造		平面结构芯片无环高耐压终端技术	特有的无环高耐压平面结构设计,避免了传统台面结构挖槽工艺的应力大、难清洗等问题,可以采用标准半导体工艺(氧化、扩散、光刻、注入、CVD 等)制备技术,达到实现更大晶圆生产、提升产品稳定性、可靠性等目的。	功率二极管
	平面芯片制造技术	平面结构芯片表面多层钝化技术	采用多层(至少 3 层)CVD 钝化膜技术,形成芯片表面所需的综合钝化保护膜。镀镍芯片采用聚酰亚胺钝化,平面玻璃电泳等保护技术,可以使平面芯片具备 5um~20um 的钝化介质层。多层 CVD 钝化膜起到固定可动电荷、稳定耐压,隔离水汽渗透,绝缘电介质等功能,从而形成芯片表面所需的综合钝化保护膜,相应产品性能稳定性优异。聚酰亚胺钝化,平面玻璃电泳技术有效解决了芯片封装中遇到的可靠性问题,提高器件极限条件下的稳定性、可靠性。	功率二极管
		平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术	特有的平面结构设计及表面多层钝化技术,避免了传统台面结构挖槽工艺的应力大、难清洗等问题,可以采用标准半导体工艺制备技术制备,达到提升产品一致性、稳定性、可靠性的目的。	功率二极管

公司目前完成技术鉴定的技术有十多种,公司运用一系列核心技术,在小信号器件的产品尺寸、功率器件的功率密度,以及产品的封装良率、市场端失效率等核心指标方面达到国内领先企业同等水平。

(1) 在小信号器件的产品尺寸方面,公司运用高密度阵列式框架设计技术、绝缘膜装片等技术提升对框架的利用效率以及装片的控制精度,运用超低弧度焊线技术保证极低的封装焊接弧度保证产品外形不断小型化;公司小信号器件主要产品品种的最小封装尺寸与扬杰

科技、苏州固锴基本持平，在优势产品小信号开关二极管、小信号三极管、小信号 MOSFET 等具备一定的产品尺寸优势；

(2) 在功率器件的功率密度方面，公司运用点胶量 CPK 自动测量控制技术、功率芯片画锡焊接技术有效解决了组装焊接过程中的可靠性问题，运用高温反向漏电控制技术等核心技术提升了功率器件在特殊工作条件下的可靠性表现，满足了器件功率密度不断提升带来的性能要求；公司功率器件主要产品品种的最高功率密度水平与扬杰科技、苏州固锴基本持平，优势产品功率整流二极管、功率稳压二极管等具备一定的优势；

(3) 在封装良率和市场端失效率方面，公司运用核心技术加强对生产过程的工艺控制，保证生产良率控制在较高水平，同时具备根据终端应用场景设计针对性测试方法的能力。测试工序，针对关键电参数运用 PAT、SBL、SYL 管理技术，在出厂前剔除潜在失效风险产品，进而保证了极低的市场端失效率。公司封装良率基本达到国内封测标杆企业华天科技同等水平，差异情况不足以对公司生产成本、生产效率产生重大影响，公司市场端失效率与扬杰科技功率器件的市场端失效率达到同等水平。

## 6.2 产品售后责任

我们把品牌产品建立在用户满意的基础上，为用户提供满意的服务，积极为顾客服务，实行售前、售中、售后服务，树立了公司产品形象和企业形象。加强了售后服务队伍建设，建立健全了各项规章制度、重视内部信息的收集，服务人员意识得到提高。

为践行质量责任，持续打造品牌，切实服务好顾客，我公司面向社会及广大顾客郑重承诺如下：

- (1) 出厂产品各指标合格率：100%；
- (2) 不发生产品质量安全事件；
- (3) 合同执行率 100%；
- (4) 国家检验部门抽检产品的质量安全指标 100%达标。

### 6.3 企业社会责任

公司本着“为客户创造价值，为员工提供平台，为股东实现回报，为社会做出贡献”的企业文化理念，严格遵守上市公司各项管理制度，持续完善环境、社会和企业治理各项工作。环境保护、员工职业健康安全是公司重点关注的议题。我们将环保理念融入公司日常生产经营中，积极推进无卤素产品、绿色工厂项目建设，以实际行动落实节能低碳理念，助力我国生态环境保护。为守护员工职业健康安全，我们贯彻实施了 ISO45001 管理体系，通过设备安全防护改造，配发劳动防护用品、日常安全隐患排查和整治以及安全应急演练等方式提升员工安全意识，降低安全隐患。

我们致力于员工与公司的相互成就。为了进一步增强企业的凝聚力，建立健全长效激励机制，2021 年 9 月我们策划并实施了股权激励计划，以激励和留住公司骨干员工，调动起工作积极性和创造性，来实现企业发展的长期目标。

### 6.4 质量信用记录

2012 年 9 月：“G 牌硅塑封微型贴片半导体分立器件”获常州市名牌产品；

2012 年 12 月：首次获得 ISO9001 及 ISO/TS16949 质量管理体系认证证书；

2012 年 12 月：获江苏省企业信用管理贯标证书；

2012 年 12 月：获常州市企业信用 AAA 等级证书；

2014 年 12 月：G 牌硅塑封微型贴片半导体分立器件获江苏名牌产品证书

2015 年 5 月：“G&BL”商标在韩国注册成功；

2016 年 9 月：获得“江苏省文明单位”称号；

2017 年 12 月：江苏省工商行政管理局公示为守合同重信用企业；

2018 年 5 月：长虹授予：2017 年度优秀供应商奖牌；

2018 年 7 月：创维授予：优秀合作伙伴奖牌；

2018 年 12 月：公司 G 牌商品被评为 2019 年度常州市重点培育和发展的国际知名品牌；

2020年3月：被评定为常州市绿色工厂；  
2021年6月：获得TCL“长期合作金奖”奖牌；  
2021年12月：被评定为江苏省绿色工厂；  
2022年1月：被英搏尔颁发“2021年度优秀合作伙伴”；  
2022年1月：被深圳世纪云芯评选我司为“2021年度优质供应商”。

## 7 结语

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑需要优秀的服务维持，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护品牌形象、打造产品质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的理念付诸于行动，不断提高工作责任心和管控力度，为广大顾客提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根、诚信为本，向质量要效益，从效益促发展，真正达到诚信经营、以质取胜！